

Dilase 650

Sistema de Litografía Directa sin Máscara

- ▶ Sistema avanzado para la fabricación de máscaras y rápido prototipaje
- ▶ Alta velocidad de litografía
- ▶ 266nm, 375nm y 405nm
- ▶ Compatible con todas las fotorresinas
- ▶ Muy alta relación de aspecto: 1x50
- ▶ Alta resolución litográfica



Dilase 650

El **Dilase 650** es un sistema de escritura directa por láser **TODO EN UNO**.

Equipo de alto rendimiento que ofrece la flexibilidad de la tecnología **sin-máscara**, la cual agiliza sustancialmente el desarrollo y optimización de los tiempos requeridos para el diseño o prototipaje de nuevos productos. Gracias a un stage rápido y preciso, el Dilase 650 permite escribir patrones en fotorresinas depositadas en sustratos de hasta 6" y máscaras de hasta 7" por medio de uno o dos láseres (375 o 405 nm).

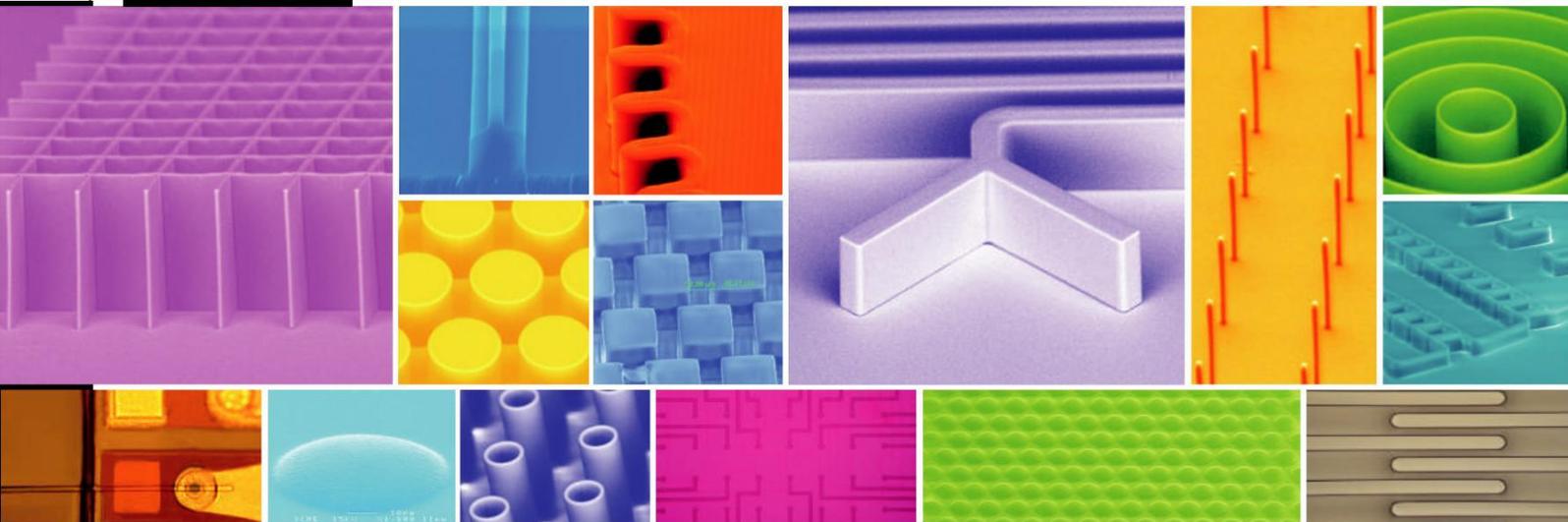
En un diseño, no siempre se requiere la resolución más alta, a veces es más importante la velocidad. Con el Dilase 650 se puede encontrar un buen compromiso entre estos dos parámetros. Este sistema puede incorporar 2 líneas ópticas, dándole la capacidad de utilizar dos spots de diferente tamaño; de esta forma es posible usar uno u otro en función de la resolución requerida, optimizando así los tiempos de escritura.

Características

- Tamaño : 1270 x 970 x 1650 mm
- Sistema Operativo (Windows)
- 1 a 2 láseres : 266, 375 y/o 405 nm
- 1 a 2 líneas ópticas
- Sistema de posicionamiento por Vídeo de Alta Resolución
- Formatos aceptados: LWI (Formato de Diseño Propio de Kloé), DXF y GDS2
- Autofocus configurable
- Software de Diseño Integrado: Kloé Design V.2
- 2 modos de escritura: vectorial y raster scan



Aplicaciones



Especificaciones

Velocidad de escritura lineal	> 500 mm.s ⁻¹
Resolución Movimiento Stage	100 nm
Repetibilidad	100 nm
Área de escritura	Obleas de 1 a 6"
Grosores de sustrato	250 µm a 10 mm
Tamaño del spot del láser (1 o 2)	1 µm a 50 µm
Factor de forma	Mínimo 10
Precisión de realineamiento	500 nm